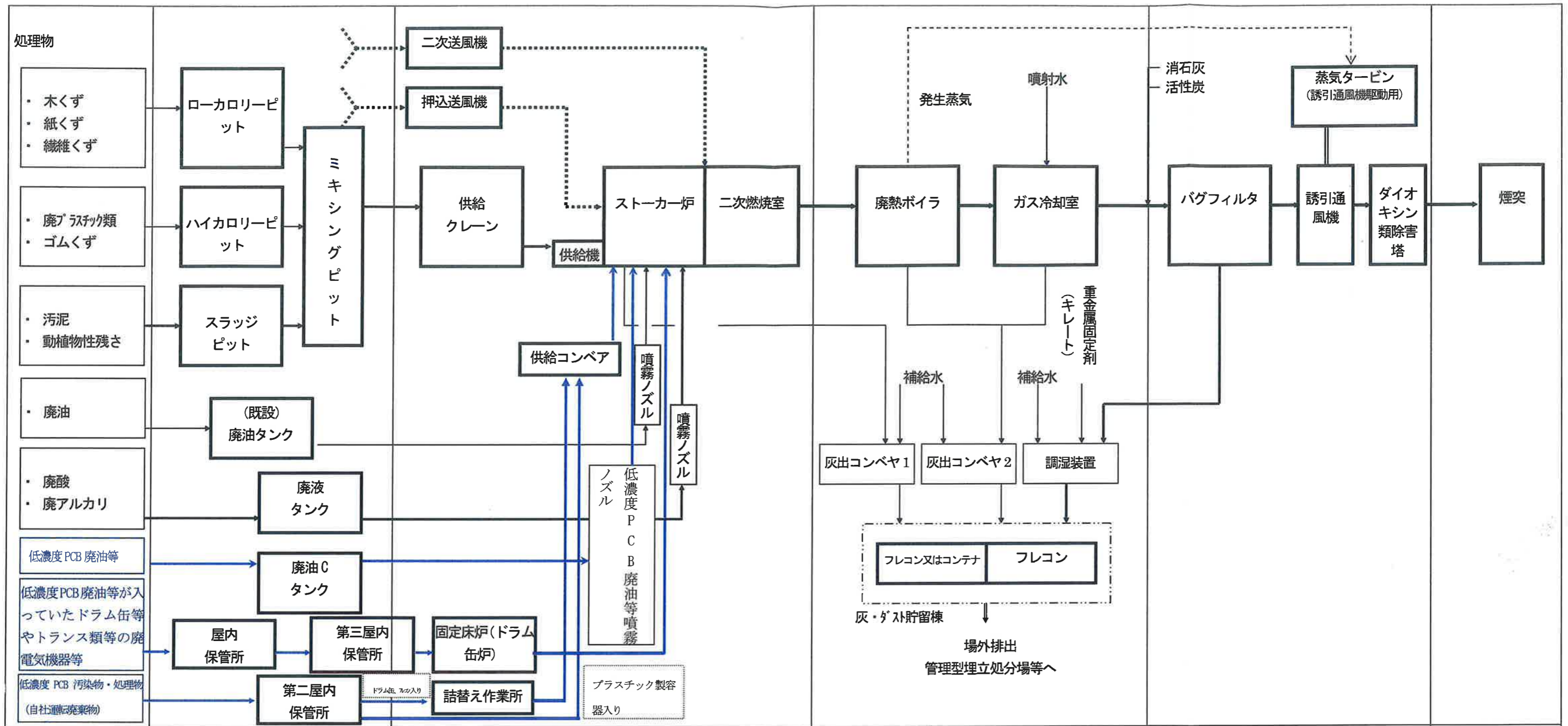


市原サーマルセンター 処理工程図 (焼却)



	保管・貯留	焼却	処理	ガス冷却	加熱残渣の保管・排出	排ガス処理	大気放出
処理内容	<ul style="list-style-type: none"> ● 固形物は供給棟(屋内)の各ピットに貯留する。 ● 焼却前に投入前、ミキシングピットにて十分に攪拌・混合する。 ● 液状物(廃油、廃酸・廃アルカリ)は密閉タンクに貯留される。 ● 低濃度 PCB 廃油等はドラム缶等の容器もしくはタンクローリーにて受入、抜油所にて廃油等を抜油し、廃油Cタンクにて貯留される。 ● 空ドラム缶等の容器は屋内保管所にて保管され、プレス作業場のプレス機にてプレスされる。 ● トランス類等は屋内保管所等にて保管され、抜油所にて廃油等を抜油し、油は廃油Cタンクに貯留され、筐体は第三屋内保管所等に保管される。 ● 低濃度 PCB 汚染物・処理物は、第二屋内保管所にて保管され、必要に応じて詰替え作業所にてプラスチック製容器へ詰替える。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 供給クレーンから受入れホッパ(コンベヤ付)を経て一定量ずつ連続的に焼却炉に送られる。 ● 機械式の連続焼却炉で、850~1000°Cの高温で焼却する。 ● 二次燃焼室は850~1000°Cで2秒以上滞留できる容積をもち、安定した廃棄物の供給による完全燃焼により、ダイオキシン類の発生を極力抑制する。 ● 廃棄物を貯留する屋内ピットから燃焼空気を取入れるため、臭気を含む(悪臭を発生する廃棄物がある場合)空気は高温分解される。 ● 低濃度 PCB 廃油等は850°C以上のストーカー炉へ噴霧され、完全燃焼される。 ● 固定床炉(ドラム缶炉)では850°C以上で2時間以上保持し、ドラム缶等の容器、トランス類及びコンデンサ類等の廃電気機器(内部部材、付属品も含む)等の金属くず、陶磁器くず、がれき類のPCBをガス化させ、ストーカー炉へ導入し、完全燃焼する。 ● プラスチック製容器に入れた低濃度 PCB 汚染物・処理物(自社運搬廃棄物も含む)は、密閉したまま、ストーカー炉の低濃度 PCB 汚染物等供給コンベヤから投入することで、850°C以上のストーカー炉にて無害化処理する。 ● 液状物(廃油、廃酸・廃アルカリ)は、各々ポンプによりノズル噴霧される。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 廃熱ボイラにて回収した蒸気は、タービンに送られ、誘引通風機を駆動する。 ● ボイラ出口後の排ガスは水噴霧により、190°Cに急冷しダイオキシン類の再合成を妨止する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 焼却灰は灰出コンベヤ1で加温後、建屋内でフレコン又はコンテナにて保管する。 ● ばいじんは、水による加温とキレート剤の添加により、重金属の溶出を防止して建屋内でフレコン保管する。 ● 燃え殻及びばいじんは、場外の管理型埋立処分場もしくは再資源化施設へ搬出する。 ● 加熱処理したドラム缶等の容器やトランス類等の廃電気機器は加熱残渣保管場所又は第三屋内保管所へ移送し、保管すると共に、PCBの無害性を定期的に分析にて確認する。加熱処理の状況等にて安全性を確認した加熱残渣は必要に応じて解体し、再資源化業者もしくは金属回収業者へ売却する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● バグフィルタにより精密集じんする。 ● バグフィルタ入口に消石灰を吹込み、酸性ガスを除去する。 ● ダイオキシン類については、前段までの発生抑制及び再合成の防止を行った後、わずかに存在するものを、バグフィルタ入口煙道に活性炭を吹込むことにより、ろ布表面で吸着除去し、出口濃度0.1ng-TEQ/m³を遵守する。 ● ダイオキシン類を軽減させることを目的として、バグフィルタを通過した後の排ガスをダイオキシン類除害塔へ導入し、ガス状のダイオキシン類を分解・除去する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 排ガスを45mの煙突から放出し拡散させる。 	

市原サーマルセンター 処理工程図 (破碎)

